

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2019-114
债券代码:114418、114423 债券简称:19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 关于投资存储芯片封测项目的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本项目可能受政府产业政策调整、市场波动、项目进度及公司经营管理等因素的影响，使得项目收益未达预期。本公司将谨慎对待各类风险，并积极采取措施防范化解风险。

一、对外投资概述

因业务发展需要，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟以本公司的控股子公司康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司（本公司持股 56%）为主体投资建设存储芯片封装测试厂。

本公司董事局于 2019 年 11 月 25 日（星期一）召开了第九届董事局第十九次会议，会议审议通过了《关于投资存储芯片封测项目的议案》。公司共有 7 名董事，会议实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。

根据《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

（一）项目名称：存储芯片封测项目。

（二）运营主体：康佳芯盈半导体科技（深圳）有限公司（本公司持股比例为 56%）。

（三）项目选址：拟选址盐城市智能终端产业园。

（四）项目关键节点：计划 2020 年底试生产。

（五）项目内容：投资建设存储芯片封装测试厂，开展存储芯片的封装测试及销售。

（六）投资金额：固定资产投资金额为 5.01 亿元。

（七）资金来源：项目公司自筹资金。

三、协议的主要内容

经友好协商，盐城高新技术产业开发区管理委员会拟与本公司签署投资协议，投资协议的主要内容如下：

（一）项目内容：投资建设存储芯片封装测试厂，开展存储芯片的封装测试及销售。

（二）项目规模：计划总投入 10.82 亿元，其中购买设备等投资约 5 亿元。

（三）项目占地：占地 100 亩（以国土部门最终出让面积为准）。

（四）生效条件：经双方签字、盖章后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本项目有利于本公司加强在半导体领域的布局，促进本公司半导体及相关业务的长远发展，可充分发挥本公司产业和科研优势并充分利用盐城高新技术产业开发区资源和政策优势，进一步提高本公司核心竞争能力和盈利能力。

本项目可能受政府产业政策调整、市场波动、项目进度及公司经营管理等因素的影响，导致项目收益未达预期。

五、备查文件

第九届董事局第十九次会议决议及相关文件。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十一月二十五日